

SiC 衬底 导电型 产品标准

| 等级 | 精选级(Z级) | 测试级 (D级) |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 直径 | 199.5 mm ~ 200.0 mm | 199.5 mm ~ 200.0 mm |
| 晶型 | 4H | 4H |
| 厚度 | 500 μm ± 25 μm | 500 μm ± 25 μm |
| 晶片方向 | 向 <112O> 偏转 4.0° ± 0.5° | 向 <1120> 偏转 4.0° ± 0.5° |
| 微管密度 | ≤ 0.2 cm ⁻² | ≤ 5 cm ⁻² |
| 电阻率 | 0.015 ~ 0.025 Ω·cm | 0.015 ~ 0.028 Ω·cm |
| Notch 晶向 | {10-10} ± 5.0° | {10-10} ± 5.0° |
| 边缘去除 | 3 mm | 3 mm |
| 局部厚度变化/总厚度变化/弯曲度/翘曲度 | ≤ 5 µm / ≤ 10 µm / ± 35 µm / 70 µm | ≤ 10 μm / ≤ 15 μm / ± 50 μm / 100 μm |
| 表面粗糙度 | 抛光 Ra ≤1 nm | 抛光 Ra ≤1 nm |
| | CMP Ra ≤ 0.2 nm | CMP Ra ≤ 0.5 nm |
| 边缘裂纹(强光灯观测) | _ | 累计长度 ≤ 30 mm 单个长度 ≤ 2 mm |
| 六方空洞(强光灯观测) | 累积面积 ≤ 0.05% | 累积面积 ≤ 0.1% |
| 多型(强光灯观测) | _ | 累积面积≤3% |
| 目测包裹物(日光灯观测) | 累积面积 ≤ 0.05% | 累积面积≤3% |
| 硅面划痕(强光灯观测) | _ | 累计长度 ≤1 x 晶圆直径 |
| 崩边(强光灯观测) | ———————————————————————————————————— | ≤9个,每个≤1mm |
| 穿透螺位错(TSD) | ≤ 300 cm ⁻² | _ |
| 硅面污染物(强光灯观测) | _ | _ |
| 包装 | 多片卡塞/单片盒包装 | 多片卡塞/单片盒包装 |

